



# Call for Papers



## 19. Internationaler Kongress mit Fachausstellung

16. und 17. Oktober 2019, Bonn

**Einreichungsfrist**  
**01. März 2019**

[www.eliv-congress.de](http://www.eliv-congress.de)

### Schwerpunktthemen 2019:

#### Megatrends:

Zukunft der Mobilität

Elektro-Fahrzeuge | Elektrifizierung

Next Level Hochautomatisiertes Fahren

End-2-End Networking

(Mission) Digitalisierung

#### Enabler:

On Board Electronics 2.0

Security

Architekturen und Software

UX

# Vorwort

## Mission Transformation

Die Planung der ELIV läuft auf Hochtouren und wir blicken schon voller Vorfreude auf das Jahr 2019. Ein wenig hatten wir schon selbst Respekt, vor unserer Idee, die ELIV 2017 von Baden-Baden nach Bonn zu verlegen. Umso mehr freuten wir uns über die überwältigende Rückmeldung von Teilnehmern, Referenten, Ausstellern und Presse zu diesem Schritt. Vor allem die dargebotene Professionalität und Internationalisierung des Kongresses als auch der deutliche Anstieg der Anzahl der Teilnehmer haben alle unsere Erwartungen bei weitem übertroffen.

Unsere Welt ändert sich weiter dramatisch. Die modernen Technologien, künstliche Intelligenz, Blockchain, Cyber Security, Big Data, als auch eine zunehmende Serviceorientierung, nehmen verstärkt Einzug in das automotive Umfeld. Disruptive Ansätze in der Technik, der Organisation und den Prozessen werden erarbeitet, um in der Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Nach einer ersten Phase der Orientierung forschten und entwickelten OEMs und Zulieferer an elektrischen, automatisierten und mit der Umwelt vernetzten Systemen.

Jetzt ist es an der Zeit zu liefern. Beste Gelegenheit auf der ELIV 2019 zu resümieren und ELIV-typisch Technik und Strategien in dem Mix zwischen Managementvorträgen und technischem Tiefgang kontrovers zu diskutieren. Unter dem Motto „Mission Transformation“ möchten wir für die „Zukunft der Mobilität“, „nächstes level Hochautomatisiertes Fahren“ und die Weiterentwicklung der „totalen Vernetzung“ aus dem Blickwinkel der Elektronik und Software eine Bühne bieten.

Auch der Weiterentwicklung der ELIV-Klassiker soll unter den Überschriften wie „On board electronics 2.0“ und „UX“, genügend Raum für inspirierende Beiträge geboten werden.

Der Programmausschuss hat sich für die ELIV 2019 zum Ziel gesetzt, die Internationalität und die Möglichkeiten zum Netzwerken noch weiter auszubauen. Mit interaktiven Elementen und der Einrichtung von Länderpavillons wollen wir auf dem Kongress hierfür neue Akzente setzen. Hierzu lade ich Sie ein, sich zu diesen Themen mit ihren Vor- und Beiträgen aktiv miteinzubringen.

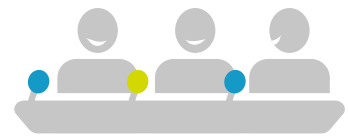
Ich selbst habe vor vielen Jahren auch einen Fachvortrag auf diesem Kongress gehalten. Dabei ist mir eine nachhaltige und positive Erinnerung sowie ein heute noch funktionierendes Netzwerk geblieben. Das motiviert mich immer wieder, diesen Kongress aktiv zu unterstützen.

Ich hoffe, dass ich Sie begeistern konnte, auf dem weltgrößten automotive Elektronik Kongress Ihren Impuls mit einem Vortrag zu setzen. Setzen Sie neue Trends in unserer Mission Transformation, ich freue mich darauf.

**Dipl.-Ing. Uwe Michael**

Vorsitzender des Programmausschusses

## Programmausschuss



**Dipl.-Ing. Harald Deiss**, Vice President Electronic Systems, ZF Friedrichshafen AG, Auerbach



**Dr. Christoph Grote**, Bereichsleiter Elektronik, BMW AG, München



**Dipl.-Ing. Christof Kellerwessel**, Chief Engineer Electrical and Electronic Systems Engineering, Ford-Werke GmbH, Köln



**Dipl.-Ing. (FH) Helmut Matschi**, Mitglied des Vorstands, Division Interior, Continental AG, Regensburg



**Dipl.-Ing. Uwe Michael**, Director Electric/Electronic, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Weissach (Vorsitz)



**Dr. Burkhard Milke**, Director GME Electrical Systems & Infotainment, Hybrids & Electrical Vehicle, Adam Opel AG, Rüsselsheim



**Dr. Thomas M. Müller**, Leiter Entwicklung Elektrik/Elektronik, AUDI AG, Ingolstadt



**Dipl.-Ing. Bernd Münsterweg**, Executive Vice President, Member of the Management Board Electronics, Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt



**Dr.-Ing. Dieter Rödder**, Senior Vice President Advance Engineering Systems 1 – Future Automotive Systems, Robert Bosch GmbH, Stuttgart



**Dr. Jutta Schneider**, Bordnetztechnologie & E/E Gesamtentwurf, Daimler AG, Sindelfingen



**Dr. Volkmar Tanneberger**, Bereichsleiter des Fachbereichs Elektrik/Elektronik Entwicklung, Volkswagen AG, Wolfsburg



**Dipl.-Ing. Stefan Teuchert**, President and CEO E/E Function Development, E/E Function Development BMW Group Russia, BMW AG, München



**Dr. Rolf Zöller**, Leitung Elektrik-/Elektronik-Entwicklung, Volkswagen AG, Wolfsburg

## Aufruf zur Einreichung von Beiträgen

Sind Sie Experte auf einem der unter Schwerpunktthemen genannten Gebiete? Dann rufen wir Sie auf, mit einem Vortrag aktiv zum Erfolg dieses Kongresses beizutragen. Bitte reichen Sie bis zum 01. März 2019 eine Kurzfassung im Umfang von max. einer DIN A4-Seite ein. Auf der Internetseite [www.eliv-congress.de](http://www.eliv-congress.de) können Sie sich mit Ihrem Beitrag online einschreiben.

### Die Kurzfassung muss enthalten: (Umfang: max. eine DIN A4 Seite!)

- Den aussagefähigen Titel Ihres Beitrags
- Die Daten des Vortragenden und der Co-Autoren (Namen und Kontaktdaten)
- Eine Inhaltsangabe mit spezifischen Informationen
- Eine Aussage zum Innovationsgrad
- Die Zuordnung zum thematischen Schwerpunkt (bitte auch in der Word-Datei)
- Die Angabe von Veröffentlichungen zum Thema

Im Interesse aller Teilnehmer möchten wir Sie bitten von reinen Produktpräsentationen abzusehen. Im Fokus des Kongresses soll der Austausch über die neuesten Lösungen, Produkte, Entwicklungen und Technologien stehen.

Die Entscheidung über die Annahme und Einordnung eines Vortrags in das Kongressprogramm trifft der Programmausschuss.

## Bewertungskriterien der Kurzfassungen

Nach Ablauf der Einreichungsfrist wird der Programmausschuss die eingereichten Kurzfassungen bewerten. Um den Auswahlprozess und die Kriterien transparenter zu gestalten, finden sich im Folgenden letztere beschrieben. Einreichende werden gebeten ihr Abstrakt vor der Einreichung noch einmal entsprechend kritisch zu prüfen, ob alle Fragen anhand der Kurzfassung schnell zu beantworten sind. Bitte denken Sie unbedingt daran, dass die Kurzfassung inkl. aller weiteren Informationen nur eine DIN A4 Seite umfassen sollte.

## Inhalt

- Aktualität: Spielt das Thema momentan und in Zukunft eine Rolle in der Industrie und/oder Wissenschaft? Gab es diesen Beitrag bereits auf einer anderen Veranstaltung?
- Neuigkeitsgehalt (Innovationsgrad): Bieten sich neue Ansätze/Ideen oder wird das Produkt/die Methode etc. bereits eingesetzt?
- Relevanz des Themas: Ist das Thema relevant für den Kongress? Findet sich das Thema unter den Schwerpunkten wieder?
- Entwicklungsstand: Geht das im Beitrag thematisierte Produkt/die Dienstleistung o.Ä. demnächst in die Serienreife oder wird es/sie bereits in der Serienproduktion eingesetzt?
- Ganzheitlicher Ansatz: Gibt es eine holistische Betrachtungsweise?
- Anwendungsbezogenheit: Ist die im Beitrag vorgestellte Neuerung/Lösung bereits praktisch anwendbar? Gibt es Praxisberichte? Welchen Nutzen können Zuhörer aus dem Vortrag ziehen?
- Wissenschaftliches Niveau: Gibt es Referenzen?
- Enthält der Vortrag eine strategische Aussage, Handlungsempfehlung oder Standardisierungsvorschläge?

## Qualität des Abstracts

- Wurden die formellen Rahmenbedingungen bei der Einreichung/des Abstracts eingehalten? (1 DIN A4 Seite)
- Ist ein roter Faden erkennbar?
- Welchen Umfang bietet das Thema? Tiefgreifend?
- Wird der Sachverhalt verständlich und übersichtlich dargestellt?

## Profil des Vortragenden

- Wie viele Jahre Erfahrung in der Automobilbranche?
- Referenzen

## Allgemeine Hinweise (Kurzfassungen und Manuskript)

- Die Kurzfassungen bitte in deutscher und englischer Sprache einreichen.
- Die Vortragszeit beträgt ca. 25 Minuten mit anschließender Diskussion von ca. 5 Minuten. Die Autoren der angenommenen Vorträge verpflichten sich, ein ausführliches Manuskript (max. 10-12 Seiten) einzureichen. Die Manuskripte werden in einem VDI-Bericht im Downloadbereich der Homepage veröffentlicht.
- Das Manuskript sowie die Präsentationsfolien sind auf Englisch zu verfassen.
- Zusätzlich zum Manuskript werden die Referenten gebeten, einige Wochen vor dem Kongress die wichtigsten 3-4 Kernaussagen des Vortrags anzugeben. Weitere Informationen dazu erhalten die Referenten gesondert.

## Kosten

- Vortragende (je Beitrag ein Autor) nehmen kostenfrei an der Tagung teil. Reise- und Unterbringungskosten werden nicht erstattet.



## Kongresssprache

Deutsch und Englisch

Simultanübersetzung Deutsch Englisch

## Termine

Einsendeschluss für Kurzfassungen: 01. März 2019

Einsendeschluss des Einreicherfragebogens: 22. März 2019

Benachrichtigung der Autoren: Ende April 2019

Eingabeschluss für endgültige Manuskripte: 19. Juli 2019

## Nachwuchspreis „Auto-Electronic Excellence Award 2019“

Auch 2019 werden die drei besten Jungvortragenden (bis einschl. 33 Jahre) mit dem Auto-Electronic Excellence Award 2019 ausgezeichnet. Die Experten des Programmausschusses bewerten die Vorträge nach zahlreichen Kriterien wie Neuigkeitsgrad, wissenschaftliches Niveau und Anwendungsbezug. Der Tagungsleiter überreicht den Gewinnern am Ende der Veranstaltung die Preise. (Die Preise können nur persönlich entgegengenommen werden. Eine nachträgliche Entgegennahme oder die Benennung eines Vertreters ist nicht möglich.)

## Der Kongress

Am 16. und 17. Oktober 2019 veranstaltet das VDI Wissensforum unter fachlicher Trägerschaft der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik den 19. Internationalen Kongress „ELIV“. Diese hochkarätige Veranstaltung ist als Branchentreff der Industrie anerkannt. Im Mittelpunkt dieses Erfahrungsaustausches steht die enge und vernetzte Zusammenarbeit zwischen Automobilhersteller und Systemlieferant als Basis von Innovation und Wirtschaftlichkeit.

## Fachlicher Träger VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik

Die VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik (FVT) bietet mit ihren acht Fachbereichen die Heimat für Ingenieurinnen und Ingenieure der unterschiedlichsten Fachrichtungen rund um die Verkehrsträger Straße, Schiene, Luft und Wasser. In einem aktiven Zusammenspiel mit den Arbeitskreisen der VDI-Bezirksvereine, den Studenten und Jungingenieuren sowie den weiteren VDI-Fachgesellschaften ist die VDI-FVT national und international mit weiteren Kooperationspartnern vernetzt. Die VDI-FVT hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Wahrnehmung des Ingenieurberufs zu stärken und den VDI als technisch-wissenschaftlichen Meinungsführer in Fachwelt, Politik und Gesellschaft verstärkt zu etablieren. Dabei gilt es, das Zusammenwirken der unterschiedlichen Mobilitätsbereiche zu forcieren und fachliche Impulse zu geben sowie Perspektiven für Querschnittsthemen rund um die Bereiche „Mensch und Mobilität“ sowie „Transportmittel und Infrastruktur“ zu entwickeln.

Nähere Informationen zur Fachgesellschaft finden Sie unter:

[www.vdi.de/fvt](http://www.vdi.de/fvt)

## Megatrends

### Zukunft der Mobilität

- Die letzte Meile
- Mobilität als Service
- Geschäftsmodelle
- Fahrzeug als Gerät
- Dienste

### End-2-End Vernetzung

- Neue Elektroarchitekturen
- On-/Off-Board Technologien und Ecosysteme
- Smart + connected Vehicle
- (5G) Verfügbarkeit
- Netzabdeckung weltweit
- Echtzeitkommunikation
- Übertragungstechnologien
- Übertragungsrobustheit
- Nahtloses Umschalten der Übertragungsvarianten

## Enabler

### U<sub>x</sub>

- Automatisiertes Fahren
- Integration von digitalen Assistenten
- Partner/Kooperationen
- Technologische Game changer (neue Technologien HUD)
- Spannungsfeld: Rechtssprechung (z.B. UX) „Driver Distraction“ international
- Fahrzeugzugang
- Motion Sickness
- Level 3+ Innenraumbeleuchtung

### Security Lifecycle Management

- Intrusion Detection
- Globale Gesetzgebung
- Anomaly Detection
- Standardisierung
- Leitstand
- Flash over the Air und OTA

### Nächstes Level

#### ADAS, HAF

- Automatisiertes Fahren, Platooning und Parken
- Sensor, Sensorfusion
- Fahrzeuglokalisierung, Karten
- Simulation, Test, Homologation
- Internationalisierung, Versicherungen
- Standardisierung (Was, Wie)
- Level 2: Demokratisierung Volumeneffekte
- Level 4/5: Neue Features
- „Offene“ Plattformen – China

### Elektrifizierung: Fahrzeuge und Technologie

- Alternative Fahrzeugkonzepte
- Batteriesysteme
- Reichweitenmanagement
- Ladeinfrastruktur
- Nutzererfahrung Laden
- Leistungselektronik: Halbleiter (SiC, GaN), IGBT
- Ladetechnik
- Lifecyclemanagement
- Function on demand

### Mission Digitalisierung

- Methodik (Agile), Tools, Veränderungen im SW Prozess
- Digitalisierung des Entwicklungsprozesses
- Übergreifende Zusammenarbeit zwischen Firmen (Kooperationsmodelle, Arbeitsweisen)
- Regulatorische Anforderungen & Lösungen (DSGVO)
- Digitale Technologien (z.B. KI, Blockchain, Absicherung)

### On Board Electronics 2.0

- Lichttechnik
- Kabelsatz
- On Board Elektronik
- Redundante Bordnetze/Bordnetze für HAF
- Leitungssatz
- Methoden + Test
- Energieversorgung/Energie-Bordnetz
- Verfügungsstellung, Diagnostik, Fehlerbehandlung
- Zuverlässigkeit (Halbleiter/Qualitäts-herausforderungen)
- Bauteilrisiken (Lebensdauer, Qualität, Versorgung)

### Software und Transformation

- Regulierungen
- SW & Homologation & State of the Art
- Agile Workflow/Development Processes
- SW Updates/Integration
- Complexity Management
- Modularity interfaces and testing
- HW Emulation
- Partnermanagement/Kooperationsmodelle
- Best practice free & open SW / How to open source in automotive
- Adaptive Autosar, Android

### Des Weiteren können Beiträge eingereicht werden zu den Querschnittsthemen

- Geschäftsmodelle
- Gesetze und Regulatoren (26262 - Sicherheitsentwicklungen)
- Internationalisierung
- Skalierbarkeit
- Impulse aus anderen Industrien
- Partnering (z.B. Partnerschaften generieren, Erfolgsprojekte)



# Wer bereits ausgestellt hat

3D Mapping Solutions GmbH  
A2Mac1 Automotive Benchmarking  
AB Elektronik GmbH  
AB Mikroelektronik GmbH  
Airbiquity, Inc.  
Altium Europe GmbH  
AnSem NV  
ANSYS Germany GmbH  
Arccore GmbH  
ARM Limited  
Arnold Umformtechnik GmbH & Co. KG  
Assystem GmbH  
ATS Advanced Telematic Systems GmbH  
Audi AG  
autoaid GmbH  
Autoliv B.V. & Co. KG  
AutonomouStuff, LLC  
AVL Deutschland GmbH  
Bertrandt AG  
BFFT Gesellschaft für Fahrzeugtechnik mbH  
BMW AG  
Bombardier Primove GmbH  
b-plus GmbH  
Brehmer GmbH & Co. KG  
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co KG  
BURY GMBH & CO. KG  
Cadence Design Systems GmbH  
CarsDome Robotics, Inc.  
CDA GmbH  
CMORE Automotive GmbH  
COMPREDICT GmbH  
Continental Engineering Services GmbH  
Creative Chips GmbH  
CyMotive Technologies GmbH  
Cypress Semiconductor GmbH  
Daimler AG  
Dialog Semiconductor (UK) Ltd.

Digitalwerk GmbH  
Dipl.Phys. Peer Stritzinger GmbH  
dSpace GmbH  
eccocar  
e-gnition Hamburg  
Electronic Specifier Ltd.  
Elektrobit Automotive GmbH  
Elmos Semiconductor AG  
embedded brains GmbH  
ESCRYPT GmbH – Embedded Security  
ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH  
ETAS GmbH  
Eximap  
FEV Europe GmbH  
Fraunhofer IESE  
Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit  
Fraunhofer Institute for Integrated  
Circuits IIS  
Fraunhofer IZM  
GaN Systems Inc.  
Gigatronik Holding GmbH  
Green Hills Software GmbH  
Hella Aglaia Mobile Vision GmbH  
Hesse GmbH  
Huber Automotive AG  
IAV GmbH  
Infineon Technologies AG  
Inova Semiconductors GmbH  
In-tech GmbH  
IPG Automotive GmbH  
IRYStec Software Inc.  
ITK Engineering AG  
ITK Engineering GmbH  
jambit GmbH  
JDI Europe GmbH  
K2L GmbH & Co. KG  
KA-Racelng e.V.

Knowledge Development for POF S.L  
KPIT Technologies GmbH  
Kugler Maag CIE GmbH  
Laird Bochum GmbH  
MAGNA Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co. KG  
MathWorks  
Maxim Integrated, Inc.  
Mayer GmbH & Co. KG  
Mentor Graphics (Deutschland) GmbH  
Method Park Holding AG  
Microchip Technology  
MicroFuzzy GmbH  
MicroNova AG  
Model Engineering Solutions GmbH  
MS-Schramberg GmbH & Co. KG  
Nauto, Inc.  
NNG LLC  
NovAtel Inc.  
NVIDIA Ltd.  
NXP  
OPAL-RT EUROPE  
OpenSynergy GmbH  
Optics Balzers AG  
P3 group GmbH  
paragon AG  
Parkbob GmbH  
Peer Stritzinger GmbH  
Plexim GmbH  
Porsche Engineering Group GmbH  
Preemoo  
Prisma Sales Service GmbH  
Prozesswerk GmbH  
Pulse Electronics GmbH  
Qualcomm Communications GmbH  
Renesas Electronics Europe GmbH  
ROHM Semiconductor GmbH  
RT-RK LLC

S.E.A. Datentechnik GmbH  
Savari GmbH  
Schaeffler Engineering GmbH  
Secunet Security Networks AG  
Silver Atena Electronic Systems  
Engineering GmbH  
Smart Eye AB  
Socionext Europe GmbH  
Softing Automotive Electronics GmbH  
Star Cooperation GmbH  
STMICROELECTRONICS Application GmbH  
Swissbit AG  
Synopsys Northern Europe Ltd.  
SYSGO AG  
SYSTEMITE AB  
Taoglas Limited  
Tasking  
TASS International  
Tata Elxsi Ltd.  
TDK – Micronas GmbH  
TechConnect GmbH  
Telit Communications S.p.A.  
TheWhollySee Ltd.  
Third Space Auto Ltd.  
Toposens GmbH  
TSN Systems GmbH  
TTTech Automotive GmbH  
ubirch GmbH  
u-blox AG  
Vacuumschmelze GmbH & Co. KG  
Vector Informatik GmbH  
Verein Deutscher Ingenieure e.V.  
VISPIRON SYSTEMS GmbH  
Visteon Electronics Germany GmbH  
Winbond Electronics Corp.  
Yazaki Europe Limited

## Sponsoren 2019:

Goldsponsor:



Sponsor der Abendveranstaltung:



### Fachausstellung & Sponsoring

Der 19. internationale Fachkongress „ELIV“ gehört zu den weltweit renommiertesten Kongress-Veranstaltungen für die Automobil-Zulieferindustrie. Auf der begleitenden Fachausstellung zum Kongress präsentieren auch in 2019 wieder über 145 Unternehmen innovative und zukunftsweisende Produkte und Dienstleistungen der Branche.

Die Ausstellung ist der zentrale Marktplatz des Fachkongresses, in dem sich die Kongressteilnehmer exklusiv über die Trends der Branche informieren können. Nutzen Sie diese attraktive Plattform zur Unternehmenspräsentation und steigern Sie Ihre Werbewirkung und Ihr Image bei den führenden Entscheidern der Branche durch ein individuelles Sponsoring.

**Informationen zur Fachausstellung und zum Sponsoring-Programm:**  
Martina Slominski | Telefon: + 49 211 6214-385 | E-Mail: [slominski@vdi.de](mailto:slominski@vdi.de)

Hinweis: Liegt Ihre Anmeldung zur Fachausstellung bis zum 01. Mai 2019 vor, wird Ihr Unternehmen namentlich in der Ausstellerliste des Programmheftes abgedruckt. Das Programmheft wird an ca. 10.000 qualifizierte Adressen im In- und Ausland verschickt!

Veranstaltung der VDI Wissensforum GmbH  
[www.eliv-congress.de](http://www.eliv-congress.de) • Telefon: +49 211 6214-201 | Fax +49 211 6214-154



Sie haben noch Fragen?  
Kontaktieren Sie uns einfach!

**VDI Wissensforum GmbH**  
Kundenzentrum  
Postfach 10 11 39  
40002 Düsseldorf  
Telefon: +49 211 6214-201  
Telefax: +49 211 6214-154  
E-Mail: [wissensforum@vdi.de](mailto:wissensforum@vdi.de)  
[www.eliv-congress.de](http://www.eliv-congress.de)

**Frühbucherpreis  
bis zum 10. Mai 2019  
sichern**

✓ Ich nehme an dem 19. Internationalen Kongress „ELIV“ am 16. und 17. Oktober 2019 in Bonn teil:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Preis p. P. zzgl. MwSt. | <b>19. Internationaler Kongress ELIV 2019</b>                           |
|                         | <input type="checkbox"/> 16. und 17. Oktober 2019, Bonn<br>(01TA101019) |
| <b>Teilnahmegebühr</b>  | EUR 1.590,- (Frühbucherpreis, gültig bis 10.05.2019)                    |

www

Ich interessiere mich für Ausstellung und Sponsoring

Ich bin VDI-Mitglied und erhalte **pro Veranstaltungstag EUR 50,- Rabatt** auf die Teilnahmegebühr: VDI-Mitgliedsnummer\* \_\_\_\_\_

\* Für den VDI-Mitglieder-Rabatt ist die Angabe der VDI-Mitgliedsnummer erforderlich.

**Meine Kontaktdaten:**

Nachname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Titel \_\_\_\_\_ Funktion/Jobtitel \_\_\_\_\_ Abteilung/Tätigkeitsbereich \_\_\_\_\_

Firma/Institut \_\_\_\_\_

Straße/Postfach \_\_\_\_\_

PLZ, Ort, Land \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Mobil \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Abweichende Rechnungsanschrift \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

**Teilnehmer mit einer Rechnungsanschrift außerhalb Deutschlands, Österreichs oder der Schweiz bitten wir mit Kreditkarte zu zahlen:**

Karteninhaber \_\_\_\_\_  Visa  Mastercard  American Express

Kartenummer \_\_\_\_\_ Prüfziffer \_\_\_\_\_ gültig bis (MM/JJ) \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Die **allgemeinen Geschäftsbedingungen** der VDI Wissensforum GmbH finden Sie im Internet:  
[www.vdi-wissensforum.de/de/agb/](http://www.vdi-wissensforum.de/de/agb/)

**Veranstaltungsort:**

**Bonn:** World Conference Center Bonn, Platz der Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn

**Zimmervermittlung:**

In verschiedenen umliegenden Hotels stehen Ihnen begrenzte Zimmerkontingente zu Sonderkonditionen zur Verfügung.

Bitte buchen Sie Ihr Zimmer frühzeitig. Eine Übersicht finden Sie auf [www.eliv-congress.de](http://www.eliv-congress.de)

**Tagungsbüro:**

Während des Kongresses erreichen Sie das Tagungsbüro telefonisch unter: +49 162 1351349

**Leistungen:** Im Leistungsumfang sind die Pausengetränke, Mittagessen sowie die Abendveranstaltung enthalten. Die Tagungsunterlagen werden den Teilnehmern online zur Verfügung gestellt.

**Exklusiv-Angebot:** Als Teilnehmer dieser Veranstaltung bieten wir Ihnen eine 3-monatige, kostenfreie VDI-Probenmitgliedschaft an (dieses Angebot gilt ausschließlich bei Neuaufnahme).

**Datenschutz:** Die VDI Wissensforum GmbH erhebt und verarbeitet Ihre Adressdaten für eigene Werbezwecke und ermöglicht namhaften Unternehmen und Institutionen, Ihnen im Rahmen der werblichen Ansprache Informationen und Angebote zukommen zu lassen. Bei der technischen Durchführung der Datenverarbeitung bedienen wir uns teilweise externer Dienstleister. Wenn Sie zukünftig keine Informationen und Angebote mehr erhalten möchten, können Sie bei uns der Verwendung Ihrer Daten durch uns oder Dritte für Werbezwecke jederzeit widersprechen.

Nutzen Sie dazu die E-Mail Adresse [wissensforum@vdi.de](mailto:wissensforum@vdi.de) oder eine andere oben angegebene Kontaktmöglichkeit.

Mit dem FSC® Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen, unabhängig zertifiziert nach den strengen Kriterien des Forest Stewardship Council® (FSC). Für den Druck sämtlicher Programme des VDI Wissensforums werden ausschließlich FSC-Papiere verwendet.

